

## 世界初の技術を駆使したシステム・イン・パッケージ ICパッケージング技術

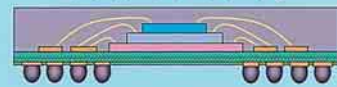
携帯電話、デジタルスチルカメラなどに使用

当社日出工場では、携帯電話・デジタルスチルカメラなどのモバイル製品の小型化、多機能化、高速化の要求に応えるためにシステム化されたパッケージによるソリューションを提供しています。

### セールスポイント

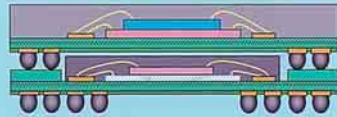
- 当社は世界24カ国に事業を展開しているグローバル企業です。IC（集積回路）の発明をはじめ、今では世界的な規模で当社のシステム・イン・パッケージを使用しています。
- マーケットシェア
  - ・ アナログIC…世界第1位（2007年、14.4%）。
  - ・ DSP（デジタル・シグナル・プロセッサ）…世界第1位（2007年、70.6%）。
- すべてが世界初
  - ・ 1958年、ジャック・キルビーによるIC（集積回路）の発明。
  - ・ 1978年、シングルチップ音声合成ICを発表。
  - ・ 1982年、DSPを発表。
  - ・ 1993年、DLPを発表。
- DLPテクノロジー  
DLP®（デジタル・ライト・プロセッシング）は当社が提供するフルデジタル映像技術の総称です。DLP®製品の心臓部にはDLP®チップという半導体を使用しています。このチップには、ミクロンサイズの超微小な鏡を48万～131万個敷き詰め、鏡にランプ光を反射させてスクリーンに映し出すユニークな映像方式を採用しています。
- 当社日出工場ではゼロ・エミッション100%達成を目指してきました。2008年11月には、ごみ“ゼロ”を達成、今は地球温暖化ガス排出削減にも取り組んでいます。

Stacked die Package (System in PKG = SiP)  
(スタック・ダイ・パッケージ)



特徴 複数のICチップが積層されている  
優れた点 実装面積の縮小に有効  
用途 携帯音楽プレーヤー/携帯電話など

Package on Package (PoP)  
(パッケージ・オン・パッケージ)



特徴 パッケージの上にパッケージを重ねる  
優れた点 高密度実装に最適  
(実装面積の縮小に有効)  
用途 携帯電話/デジタルカメラなど



スタック・ダイ・パッケージのワイヤー配線

### 経営者の一言

工場長  
児玉 衛一

米国に本社を置き、世界24カ国に事業を展開しているテキサス・インスツルメンツ（TI）は、IC（集積回路）の発明をはじめ、「アナログICとデジタル信号処理IC」における世界のリーダーです。日出工場では、卓越したオペレーションとサービスで、「工場が最高のセールスマン」を目指し、お客様に「最高の製品と安心」を提供し続けることで、特に品質に厳しい日本のお客様にも高く信頼していただき、信頼を得ています。

### profile

業 種 半導体製造  
代 表 者 工場長 児玉 衛一  
設 立 昭和43年  
資 本 金 217億5,000万円  
従 業 員 数 650人  
所 在 地 〒879-1505 大分県速見郡日出町川崎字高尾4260  
T E L 0977-72-1115 (受付)  
F A X 0977-73-1572  
U R L <http://focus.tij.co.jp/jp/tihome/docs/homepage.tsp>

事業内容 ●半導体製品の研究開発、製造販売

工場見学…可能  
インターンシップの受け入れ…可能(高校生・高専生・大学生・大学院生)  
※内容は平成21年3月時点